

各位

一般社団法人 日本半導体製造装置協会

会長 牛田 一雄



『2019年度 正会員講演会・正会員懇親会』のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会諸活動に格別のご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当協会では、来る11月21日(木)に、当協会の正会員相互の親睦を深めることを目的に、正会員講演会と正会員懇親会を開催いたします。正会員相互の懇親或いは情報交換の場としてご活用いただければ誠に幸いです。

ご多用中とは存じますが、ご参加を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

日時：2019年11月21日(木)

場所：東京會館

東京都千代田区丸の内3-2-1 <https://www.kaikan.co.jp/>
TEL 03(3215)2111正会員講演会 17:00 ~ 18:00

場所：東京會館 7F「アゼリア」

演題：『三次元積層構造を活かしたイメージセンサの進化』

講師：岩元 勇人 様

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
第2研究部門 部門長正会員懇親会 18:00 ~ 19:30(中締め)

場所：東京會館 7F「クインス」

参加費費用

5,500円(税込) /お一人様(懇親会費用として)

お申し込み方法

- * お手数ですが、添付の申込書によりFAXにてご返信下さい。
- * お申込期限は、11月12日(火)とさせていただきます。

以上

(配布先：正会員代表者、正会員窓口、理事、監事、運営委員、経済産業省)

お問い合わせ先：(一社)日本半導体製造装置協会 総務部 久野、瀬戸

TEL：03-3261-8260

FAX：03-3261-8263

e-mail：hisano@seaj.or.jp, seto@seaj.or.jp